香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 00732)

須予披露交易

L5-設備拆裝及組裝服務協議

L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議

茲提述本公司日期為二零一六年一月二十二日之公告,內容有關信利半導體購買設備。於二零一六年三月十一日,信利半導體與YMC訂立L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議。

L5-設備拆裝及組裝服務協議

於二零一六年三月十一日,本公司間接全資附屬公司信利半導體與YMC訂立 L5-設備拆裝及組裝服務協議,據此,YMC同意向信利半導體提供若干設備拆裝及組裝服務,服務費總額為36,220,000美元。

L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議

於二零一六年三月十一日,信利半導體與YMC訂立L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議,據此,YMC同意向信利半導體提供若干設備運輸、包裝、倉儲、入倉及出倉服務,服務費總額為35,260,000美元。

上市規則之涵義

由於(1) L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議於二零一六年三月十一日(自L5-設備銷售協議簽訂日期起計十二個月內)訂立;及(2) L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議共同導致本公司重大參與先前不構成本公司主要業務活動部分之第五代TFT-LCD相關業務,因此,根據上市規則第14.23條,L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議項下之交易須合併計算。

由於上市規則第14章所訂明有關L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議之若干適用百分比率合共超過5%但少於25%,故根據上市規則,L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議項下之交易各自構成本公司之須予披露交易,須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

L5-設備拆裝及組裝服務協議

主要條款

日期: 二零一六年三月十一日

訂約方: (1) 信利半導體,作為服務買方;及

(2) YMC,作為服務供應商。

主體事項: 根據L5-設備拆裝及組裝服務協議,YMC將向信利半導體提供若干服務,包括第五代TFT-LCD生產線與彩色濾光片生產線所用設備之拆裝及組裝。

服務費: 根據L5-設備拆裝及組裝服務協議,信利半導體將向YMC支付服務費合共36,200,000美元。

代價乃經公平磋商後按正常商業條款釐定。預期代價將以本集團內 部資源及銀行貸款撥付。代價將按下文所述分五期支付。 付款條款: 第一期款項10,866,000美元(相當於服務費總額30%)將於L5-設備拆裝及組裝服務協議日期後15日內支付。

第二期款項10,866,000美元(相當於服務費總額30%)將於拆裝服務完成後15日內支付。

第三期款項7,244,000美元(相當於服務費總額20%)將於設備組裝開始後15日內支付。

第四期款項5,433,000美元(相當於服務費總額15%)將於組裝服務完成後15日內支付。

餘下第五期款項1,811,000美元(相當於服務費總額5%)將於廠房驗收測試完成後15日內支付。

所有付款將以電匯形式作出。

L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議

主要條款:

日期: 二零一六年三月十一日

訂約方: (3) 信利半導體,作為服務買方;及

(4) YMC,作為服務供應商。

主體事項: 根據L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議,YMC將向信利半導體提供若干服務,包括第五代TFT-LCD生產線與彩色濾光片生產線所用設備之運輸、包裝、倉儲、入倉及出倉。

服務費: 根據L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議,信利半導體將向YMC支付服務費合共35,260,000美元。

代價乃經公平磋商後按正常商業條款釐定。預期代價將以本集團內 部資源及銀行貸款撥付。代價將按下文所述分五期支付。 付款條款: 第一期款項10,578,000美元(相當於服務費總額30%)將於L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議日期後15日內支付。

第二期款項10,578,000美元(相當於服務費總額30%)將於設備首次付運前15日內支付。

第三期款項7,052,000美元(相當於服務費總額20%)將於首次付運到達中國倉庫後15日內支付。

第四期款項3,526,000美元(相當於服務費總額10%)將於入倉服務開始後15日內支付。

餘下第五期款項3,526,000美元(相當於服務費總額10%)將於入倉服務完成後15日內支付。

所有付款將以電匯形式作出。

訂立L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議及L5-設備拆裝及組裝服務協議之理由及裨益

茲提述本公司日期為二零一六年一月二十二日之公告,內容有關L5-設備銷售協議,據此,信利半導體同意向Samsung Display Co., Ltd.購買設備以建立本集團第五代TFT-LCD生產線。由於根據L5-設備銷售協議購買之設備目前位於韓國,本集團需要將位於Samsung Display Co., Ltd.韓國廠房之設備拆裝,並將設備運送到信利半導體之中國廠房,然後進行組裝。本公司認為,YMC於提供TFT-LCD設備之拆裝與組裝及運輸服務方面擁有豐富經驗,並收取合理市價。因此,董事會認為,L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議均按正常商業條款訂立,而該等協議之條款屬公平合理,並符合股東整體利益。

上市規則之涵義

由於(1) L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議於二零一六年三月十一日(自L5-設備銷售協議簽訂日期起計十二個月內)訂立;及(2) L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議共同導致本公司重大參與先前不構成本公司主要業務活動部分之第五代TFT-LCD相關業務,因此,根據上市規則第14.23條,L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議項下之交易須合併計算。

由於上市規則第14章所訂明有關L5-設備銷售協議、L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議之若干適用百分比率合共超過5%但少於25%,故根據上市規則,L5-設備拆裝及組裝服務協議及L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議項下之交易各自構成本公司之須予披露交易,須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

有關本集團之資料

本集團之主要業務為製造及銷售液晶顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品,包括微型攝像模組、個人保健護理產品及電子設備。信利半導體為本公司之間接全資附屬公司。

有關YMC之資料

YMC之主要業務為製造電子集成電路及批發電子機器及相關材料。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,YMC及其最終實益擁有人均 為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

董事會 「董事會」 指

「本公司」 指 信利國際有限公司,於開曼群島註冊成立之公司,其

股份於香港聯合交易所有限公司上市

「董事」 指 本公司董事

「設備 | 指 信利半導體根據L5-設備銷售協議向Samsung Display

> Co., Ltd. 購買之零件、部件、機器及設備,包括第五 代TFT-LCD生產線與彩色濾光片生產線之機器及零件

本公司及其附屬公司 「本集團」 指

「L5-設備拆裝及 YMC與信利半導體就YMC向信利半導體提供若干設 指 組裝服務協議」

備拆裝及組裝服務所訂立日期為二零一六年三月十一

日之L5-設備拆裝及組裝服務協議

「L5-設備銷售協議」 Samsung Display Co., Ltd.與信利半導體就購買設備所 指

> 訂立日期為二零一六年一月二十二日之L5-設備銷售 協議,有關詳情載於本公司日期為二零一六年一月二

十二日之公告

「L5-設備運輸、

包裝及倉儲服務

協議|

YMC與信利半導體就YMC向信利半導體提供若干設 指 備運輸、包裝及倉儲服務所訂立日期為二零一六年三

月十一日之L5-設備運輸、包裝及倉儲服務協議

「上市規則」 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 指

「股東」 指 本公司股份不時之持有人

TFT-LCD 指 薄膜晶體管液晶顯示器

信利半導體有限公司,於香港註冊成立之公司,為本 「信利半導體」 指

公司之間接全資附屬公司

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣

「YMC」 指 YMC CO., Ltd.,於韓國註冊成立之公司,其主要業務

為製造電子集成電路及批發電子機器及相關材料

「%」 指 百分比

承董事會命 信利國際有限公司 *主席* 林偉華

香港,二零一六年三月十一日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生;非執行董事李建華先生;以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香 啟誠先生。